



2024年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023年8月8日

上場会社名 日本電子材料株式会社
コード番号 6855 URL <https://www.jem-net.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 坂田 輝久
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 管理部門統括部長 (氏名) 石本 浩久
四半期報告書提出予定日 2023年8月10日
配当支払開始予定日
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
四半期決算説明会開催の有無 : 無

上場取引所 東
TEL 06-6482-2007

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第1四半期の連結業績(2023年4月1日～2023年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第1四半期	4,137	3.6	258	49.2	340	49.7	226	54.7
2023年3月期第1四半期	4,292	10.4	507	55.6	677	41.8	500	39.1

(注) 包括利益 2024年3月期第1四半期 292百万円 (57.5%) 2023年3月期第1四半期 687百万円 (28.9%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第1四半期	17.96	
2023年3月期第1四半期	39.74	

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年3月期第1四半期	31,213	24,282	77.8
2023年3月期	32,691	24,242	74.2

(参考) 自己資本 2024年3月期第1四半期 24,282百万円 2023年3月期 24,242百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期		20.00		20.00	40.00
2024年3月期					
2024年3月期(予想)		20.00		20.00	40.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2024年3月期の連結業績予想(2023年4月1日～2024年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	8,100	15.3	300	75.8	300	80.4	200	81.5	15.87
通期	17,000	18.2	1,900	40.7	1,900	43.1	1,400	46.4	111.08

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年3月期1Q	12,625,314 株	2023年3月期	12,625,314 株
期末自己株式数	2024年3月期1Q	15,800 株	2023年3月期	15,800 株
期中平均株式数(四半期累計)	2024年3月期1Q	12,609,514 株	2023年3月期1Q	12,589,121 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予想情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 経営成績に関する説明	P. 2
(2) 財政状態に関する説明	P. 2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	P. 2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	P. 3
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	P. 5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 7
(継続企業の前提に関する注記)	P. 7
(重要な後発事象)	P. 7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善と各種政策の効果により、緩やかな回復傾向となりました。海外経済につきましても、ユーロ圏では景気が足踏み状態となったものの、全体的には緩やかな回復傾向となりました。しかしながら、先進国を中心に経済成長率は低迷を続けており、金融政策の引締めやインフレの長期化等による景気後退リスクは、依然として払拭されませんでした。

当社グループの主たる事業分野である半導体市場につきましては、自動車向け半導体は供給体制が正常化に向かっているものの、世界的な景気後退リスクが払拭されない中、スマートフォンやパソコン向け半導体に加え、データセンター向け半導体につきましても、需要が弱含んでいる影響等により市場が縮小し、半導体メーカーにおける生産調整も続いております。

このような事業環境の中、当第1四半期連結累計期間の売上高につきましては、非メモリー向けプローブカードは、国内外において拡販が進んだものの、メモリー向けプローブカードは、市場の冷え込みによる影響を受け、軟調に推移いたしました。以上により、売上高は前年同四半期を下回る結果となりました。利益面につきましても、売上高の減少及びプロダクトミックスの変化等により、前年同四半期を下回る結果となりました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は4,137百万円（前年同四半期比3.6%減）、営業利益は258百万円（前年同四半期比49.2%減）、経常利益は340百万円（前年同四半期比49.7%減）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、226百万円（前年同四半期比54.7%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,478百万円減少し、31,213百万円となりました。

これは主として、現金及び預金が755百万円、建設仮勘定が112百万円増加しましたが、売掛金が1,817百万円、仕掛金が194百万円、原材料及び貯蔵品が78百万円減少したこと等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,518百万円減少し、6,931百万円となりました。

これは主として、設備電子記録債務が249百万円増加しましたが、買掛金が570百万円、短期借入金が500百万円、賞与引当金が239百万円、長期借入金が216百万円減少したこと等によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ39百万円増加し、24,282百万円となりました。

これは主として、利益剰余金が25百万円減少しましたが、為替換算調整勘定が64百万円増加したこと等によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループの主たる事業分野である半導体市場につきましては、中長期的には、デジタル社会への移行が世界中で進む中、半導体は、様々な製品において需要の拡大が予想されており、それらを背景として、新たな半導体工場の建設等、半導体製造基盤の確保・強化に向けた動きも広がっております。

一方、足元においては、世界的な景気後退リスクが払拭されない中、スマートフォンやパソコンの需要の冷え込み等により、半導体メーカーの生産調整は長期化しており、半導体製造装置の市場も前年に対して一旦縮小が予想される等、先行きの不透明感は増しております。

第2四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、現時点では、2023年5月15日に公表いたしました業績予想に変更はございません。なお、引き続き今後の業績動向を踏まえ精査をしており、修正の必要が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	12,779	13,534
受取手形	—	0
電子記録債権	1,207	1,162
売掛金	6,875	5,057
有価証券	30	31
製品	441	444
仕掛品	1,012	817
原材料及び貯蔵品	2,298	2,220
その他	362	315
貸倒引当金	△13	△10
流動資産合計	24,994	23,573
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,348	2,311
機械装置及び運搬具（純額）	2,982	2,924
建設仮勘定	284	396
その他（純額）	1,151	1,123
有形固定資産合計	6,767	6,755
無形固定資産	202	186
投資その他の資産		
その他	728	699
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	727	698
固定資産合計	7,697	7,640
資産合計	32,691	31,213
負債の部		
流動負債		
支払手形	0	—
電子記録債務	1,014	993
買掛金	1,275	705
設備電子記録債務	119	369
短期借入金	500	—
1年内返済予定の長期借入金	906	881
賞与引当金	507	267
その他	1,169	1,006
流動負債合計	5,493	4,223
固定負債		
長期借入金	2,775	2,558
その他	180	149
固定負債合計	2,955	2,707
負債合計	8,449	6,931

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,053	3,053
資本剰余金	3,272	3,272
利益剰余金	17,509	17,483
自己株式	△15	△15
株主資本合計	23,819	23,794
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2	3
為替換算調整勘定	419	484
その他の包括利益累計額合計	422	488
純資産合計	24,242	24,282
負債純資産合計	32,691	31,213

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2022年4月1日 至2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年6月30日)
売上高	4,292	4,137
売上原価	2,779	2,755
売上総利益	1,512	1,382
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	225	236
退職給付費用	4	4
研究開発費	355	457
その他	419	425
販売費及び一般管理費合計	1,005	1,124
営業利益	507	258
営業外収益		
受取利息	2	5
受取配当金	21	22
為替差益	143	57
その他	9	2
営業外収益合計	177	88
営業外費用		
支払利息	6	5
その他	0	0
営業外費用合計	7	5
経常利益	677	340
特別利益		
補助金収入	126	—
特別利益合計	126	—
税金等調整前四半期純利益	803	340
法人税、住民税及び事業税	185	76
法人税等調整額	118	37
法人税等合計	303	113
四半期純利益	500	226
親会社株主に帰属する四半期純利益	500	226

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
四半期純利益	500	226
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△0	0
為替換算調整勘定	187	64
その他の包括利益合計	187	65
四半期包括利益	687	292
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	687	292

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。